Schleppkettenleitung
FABER® BUS DeviceNet EFK

DERZEIT KEIN BILD VERFÜGBAR. | NO IMAGE AVAILABLE.

Verwendung: DeviceNet (TM) Leitungen sind für den Anschluss an das von Allen Bradley (Rockwell Automation) entwickelte Bussystem vorgesehen. Die Ausführung mit den größeren Querschnitten wird üblicherweise als Backbone- (Trunk) Leitung verwendet, die Variante mit den geringeren Querschnitten als Stichleitung (Drop) für den Anschluss diverser Endgeräte.

Aufbau und technische Daten:

Leitermaterial:	Cu, verzinnt
Leiterklasse:	Kl.6 = feinstdrähtig
Schirm über Verseilelement:	Kunststoffbeschichtete Al-Folie + Cu-Beilauflitze, verzinnt
Schirm über Verseilung:	Cu-Geflecht, verzinnt
Mantelmaterial:	Polyurethan
Mantelfarbe:	violett
Flammwidrigkeit:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Halogenfrei:	ja
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt, °C:	-25 - +80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung, °C:	-30 - +70 °C
Biegeradius, fest verlegt:	8 x Ø
Biegeradius, bewegt:	15 x Ø
Wellenwiderstand:	120 Ohm

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Außendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

FABER® BUS DeviceNet EFK

Aderkennzeichnung:	weiß/blau + rot/schwarz
Betriebsspitzenspannung, V:	300 V

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø [mm]	Cu	G [kg]
100842	DeviceNet (TM) Bus FRNC 1X2X AWG 18 + 1X2X AWG 15 EFK Thick VL UL-Style CMX 75 C CL2X	12,3	94	197
100843	DeviceNet (TM) Bus FRNC 1X2X AWG 24 + 1X2X AWG 22 EFK Thin VL UL-Style CMX 75 C CL2X	7,3	36	65

Ø	Außendurchmesser ca.
Cu	Kupferzahl (de)
G	Nettogewicht per 1000